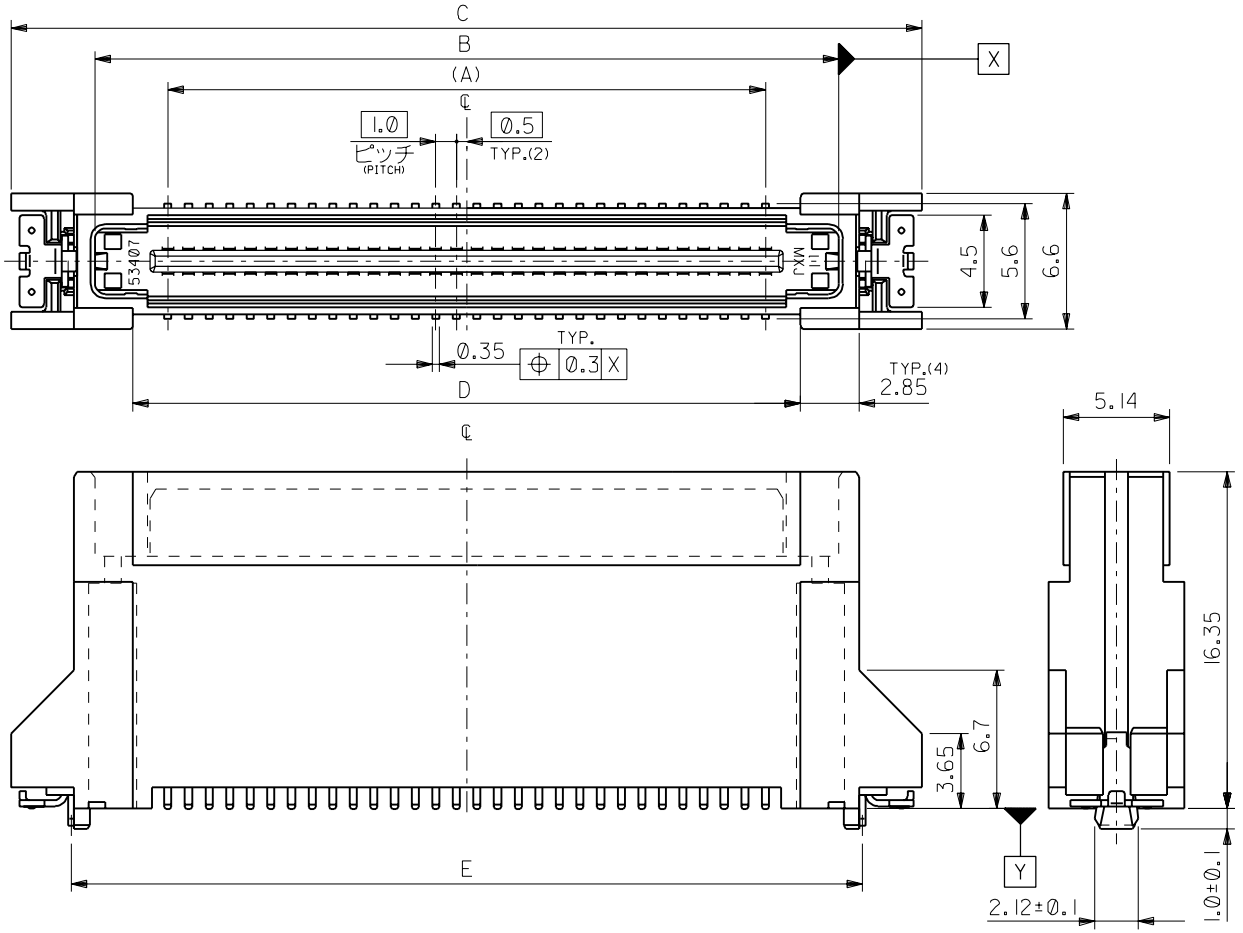
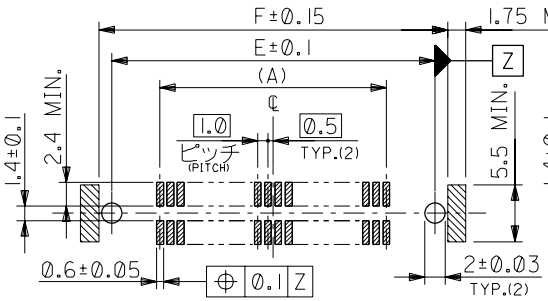
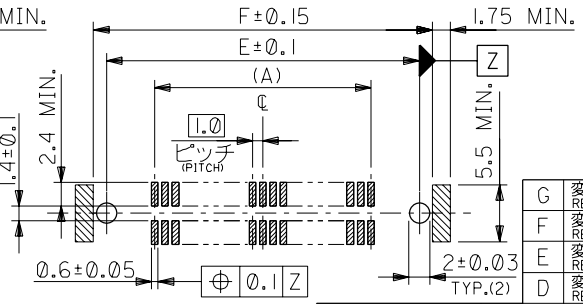
DWG. NO. SD-53408-***0

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING





推奨基板寸法（20,24,60,80,100,120,140極）
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (20,24,60,80,100,120,140CKTS.)
(SCALE 2-1)



推奨基板寸法（50極）
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (50 CKTS.)
(SCALE 2-1)

注） NOTES

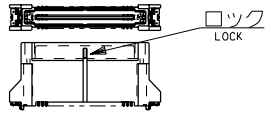
1. 材質
MATERIAL
ハウジング：ガラス入りＬＣＰ、白色、ＵＬ９４Ｖ－０
HOUSING:G.F.LCP,WHITE ,UL94V-0
ターミナル：燐青銅（ｔ＝0.2）
TERMINAL:PHOSPHOR BRONZE
金属ペグ　：燐青銅
METAL PEG : PHOSPHOR BRONZE

2. メッキ仕様
PLATING
ターミナル　接点部　：金メッキ0.25μmＭＩＮ。
TERMINAL　CONTACT AREA:GOLD 0.25 μmM I N.
半田付け部：半田メッキ1.0μmＭＩＮ。
SOLDER TAIL AREA:TIN-LEAD 1.0 μmM I N.
下地メッキ：ニッケルメッキ 2.0μmＭＩＮ。
UNDER-PLATING:NICKEL 2.0 μmM I N.
金属ペグ　半田付け部：半田メッキ 3.5 μmＭＩＮ。
METAL PEG　SOLDER TAIL AREA : TIN-LEAD 3.5 μmM I N.

3. 推奨基板厚
RECOMMENDED PCB THICKNESS
1.0±0.1mm　MIN.

4. テールのバラツキ寸法
TAIL COPLANARITY
テールは、Ｙ面を基準とし、上へ 0.02 下へ 0.15 の範囲にあり、且つテール平坦度は 0.15 とする。
TAILS TO BE WITHIN 0.02 UPWARD AND 0.15 DOWNWARD FROM Y-DATUM PLANE, AND TAIL COPLANARITY TO BE 0.15.

5. ロックは、２０、２４、５０極に設置する。
LOCK TO BE ADDED TO 20,24 AND 50 CKTS.



6. 梱包
PACKAGING
本製品はスティック梱包とし梱包後のＥＮＧ。ＮＯ。は５３４０８－＊＊＊９とする。
THIS PRODUCTS TO BE PACKED IN TUBE . ENG. NO. : 53408-•••9

7. 同一基板内に複数個（２ケ以上）の使用は避けてください。
MXJ DOES NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.BOARD.

F	E	D	C	B	(A)	ENG. NO.	極数 NO.OF CKTS.
80.9	78.4	72.4	84.2	76.02	69	53408-1400	140
70.9	68.4	62.4	74.2	66.02	59	53408-1200	120
60.9	58.4	52.4	64.2	56.02	49	53408-1000	100
50.9	48.4	42.4	54.2	46.02	39	53408-0800	80
40.9	38.4	32.4	44.2	36.02	29	53408-0600	60
35.9	33.4	27.4	39.2	31.02	24	53408-0500	50
22.9	20.4	14.4	26.2	18.02	11	53408-0240	24
20.9	18.4	12.4	24.2	16.02	9	53408-0200	20

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. / CHK.	日付 DATE
G	変更 REVISED (JD2001-1424)	T.H / T.H	'01/04/19
F	変更 REVISED (JD60150)	J.M / Y.I	'95/08/10
E	変更 REVISED (T40044)	S.A / J.M	'94/01/27
D	変更 REVISED (T30585)	S.M / M.S	'93/12/1
C	変更 REVISED (T30434)	S.M / S.I	'93/9/8
B	変更 REVISED (T30355)	J.M / Y.I	'93/7/15
A	変更 REVISED (T30275)	S.M / M.S	'93/6/8
Ø	新規作成 RELEASED	H.H / M.S	'93/2/18

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	
被覆外径 INS. RANGE	
DRAWN BY	M. Hirata
CHK'D BY	M. Nagao
APP'D BY	
尺度 SCALE	4-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
1.0 B-TO-B
S/T PLUG HS'G ASS'Y

DWG. NO. SD-53408-***0

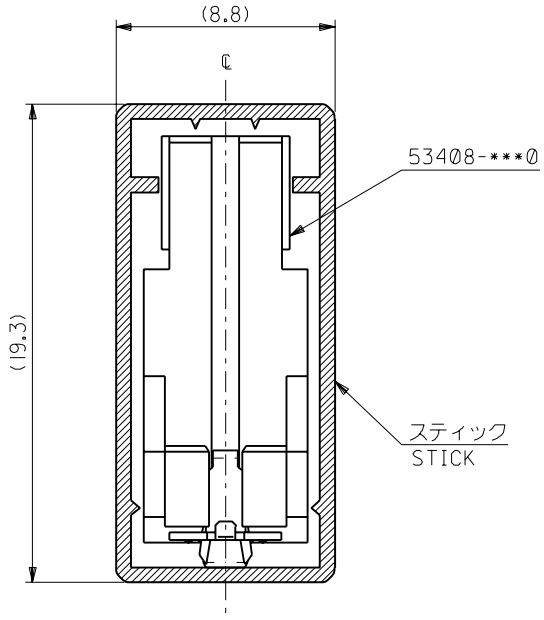
REV G

ZF3:110.0341S53408.DGN

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-53408-***9



注記
NOTES

1. スティック両端はキャップ止め。
   BOTH ENDS WITH CAPS.
2. 全　長：600±2
   TOTAL LENGTH
3. 肉　厚：0.6±0.2
   THICKNESS

梱包数 QUANTITY	ENG. No.	極数 NO. OF CKTS.
6	53408-1409	140
7	53408-1209	120
8	53408-1009	100
10	53408-0809	80
13	53408-0609	60
14	53408-0509	50
21	53408-0249	24
23	53408-0209	20

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 OVER 30未満 UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR./CHK.	日付 DATE
G	変更 REVISED (JD2001-1424)	T.H / T.H	'01/04/19
F	変更 REVISED (JD60150)	J.M / Y.I	'95/08/10
E	変更 REVISED (T30648)	S.A / J.M	'93/12/24
D	変更 REVISED (T30585)	S.M / M.S	'93/12/1
C	変更 REVISED (T30585)	S.M / M.S	'93/11/25
B	変更 REVISED (T30434)	S.M / S.I	'93/9/8
A	変更 REVISED (T30275)	S.M / M.S	'93/6/8
0	新規作成 RELEASED (T30010)	S.M / M.S	'93/1/29

材料 MATERIAL
スティック：ポリ塩化ビニル
STICK　：P.V.C.

仕上げ FINISH —//—

適用電線範囲 WIRE RANGE —//—

被覆外径 INS. RANGE —//—

DRAWN BY S. Maruyama
CHK'D BY M. Ashoo
APP'D BY H. Yamaya
尺度 SCALE 5-1

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
53408-***0
STICK PACKAGING

DWG. NO. SD-53408-***9
REV G

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING
: MM

ZF3:[110,034]S53408ST.DGN

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0JC(032)MX.J-33